

実装技術アラカルトⅡ

最先端半導体実装技術と将来展望

A la carte Packaging Technologies II:
Advanced Semiconductor Packaging Technologies and Those Future Prospects

2025年3月15日 (土) 13時30分～17時30分、K101 (講義棟)

主催：シリコンテクノロジー分科会 共催：エレクトロニクス実装学会



1. 半導体実装技術の概論

菅沼 克昭 (大阪大学)

2. High Bandwidth Memory (HBM) におけるChip-Package Interaction

横井 直樹 (マイクロンメモリジャパン)

3. 集積デバイス熱設計

内田 建 (東京大学)

4. 2.xD/3D集積・パッケージング技術

栗田 洋一郎 (東京科学大学)

5. 光電融合デバイス実装

那須 秀行 (古河電気工業株式会社)

6. 量産実績を持つOKI独自の異種材料 接合技術CFBとその未来への展望

鈴木 貴人 (沖電気工業株式会社)

7. モビリティの進化に向けた車載機器の 動向と実装・パッケージ構造

三宅 敏広 (車載エレクトロニクス実装研究所)

シリコンナノエレクトロニクス分野では、光配線技術、各種センサ、光電・熱電デバイス、パワーマネジメントデバイス、MEMS/NEMSなどの異種機能デバイスをシリコンUSLIに融合・集積するMore than Moore技術が求められています。これにより、半導体集積回路の多機能化、高効率化、省電力化、超小型化が進められています。近年、進化の著しい実装技術がこれらのデバイス融合に大きく貢献しており、新材料・新プロセスを用いた実装技術による実用化が進んでいます。

今回のシンポジウムでは、先端エレクトロニクスにおける最先端実装技術や関連分野との連携を紹介し、異分野間で課題・知見を共有、議論することで、新技術創成や新たな協働の機会を提供します。

世話人：中塚 理 (名古屋大学)、井田 次郎 (金沢工業大学)、宮下 桂 (東芝デバイス&ストレージ株式会社)、木下 啓藏 (アイオーコア株式会社)、松永 範昭 (アプライドマテリアルズ)、井上 史大 (横浜国立大学)